第一图书网, tushu007.com

<<电子产品生产工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品生产工艺>>

13位ISBN编号：9787111340669

10位ISBN编号：7111340663

出版时间：2011-10

出版时间：机械工业出版社

作者：李宗宝 编

页数：257

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

<<电子产品生产工艺>>

内容概要

《21世纪高职高专电子信息类规划教材：电子产品生产工艺》以培养学生的动手能力为目标，以小型电子产品为载体，把现代电子产品生产工艺相应的内容融入到工作任务中，具体直观地介绍了电子产品安装与调试的基本工艺和操作技能。
内容包括常用电子元器件的识别与检测、通孔插装元器件电子产品的手工装配焊接、印制电路板的制作工艺、通孔插装元器件的自动焊接工艺、表面贴装元器件电子产品的手工装接、表面安装元器件的贴片再流焊工艺、电子产品整机装配工艺、电子产品的调试工艺及电子工艺文件的识读与编制。
《21世纪高职高专电子信息类规划教材：电子产品生产工艺》按照基于工作过程的课程方式进行编写。
全书共分9章，每一章均包含“任务驱动”、“任务资讯”、“任务实施”、“相关知识”、“任务总结”与“练习与巩固”，以完成工作任务为目标来激发学生的学习兴趣，调动学生主动学习的积极性。
《电21世纪高职高专电子信息类规划教材：电子产品生产工艺》可作为高职高专院校电子类专业及相关专业的教材，也可作为从事电子产品生产工艺的技术人员的参考书。

书籍目录

目录前言第1章 常用电子元器件的识别与检测1.1 任务驱动：调幅收音机元器件的识别与检测1.1.1 任务描述1.1.2 任务目标1.1.3 任务要求1.2 任务资讯1.2.1 电阻器的识别与检测1.2.2 电容器的识别与检测1.2.3 电感器的识别与检测1.2.4 二极管的识别与检测1.2.5 晶体管的识别与检测1.2.6 电声器件的识别与检测1.2.7 开关、接插件的识别与检测1.3 任务实施1.4 相关知识1.4.1 继电器1.4.2 各种特殊二极管的识别与检测1.4.3 半导体分立器件的命名1.4.4 场效应晶体管1.5 任务总结1.6 练习与巩固第2章 通孔插装元器件电子产品的手工装配焊接2.1 任务驱动：调幅收音机的手工装配焊接2.1.1 任务描述2.1.2 任务目标2.1.3 任务要求2.2 任务资讯2.2.1 常用导线和绝缘材料2.2.2 常用焊接材料与工具2.2.3 通孔插装电子元器件的准备工艺2.2.4 导线的加工处理工艺2.2.5 通孔插装电子元器件的安装工艺2.2.6 通孔插装电子元器件的手工焊接工艺2.3 任务实施2.3.1 手工装接的工艺流程设计2.3.2 元器件的检测与引线成形2.3.3 元器件的插装焊接2.3.4 装接后的检查试机2.4 相关知识2.4.1 焊接质量与缺陷分析2.4.2 手工拆焊方法2.4.3 磁性材料与粘接材料2.5 任务总结2.6 练习与巩固第3章 印制电路板的制作工艺3.1 任务驱动：直流集成稳压电源电路板的手工制作3.1.1 任务描述3.1.2 任务目标3.1.3 任务要求3.2 任务资讯3.2.1 半导体集成电路的识别与检测3.2.2 印制电路板基础3.2.3 印制电路板的设计过程及方法3.2.4 手工制作印制电路板工艺3.3 任务实施3.3.1 电路板手工设计3.3.2 电路板手工制作3.3.3 电路板插装焊接3.3.4 装接后的检查测试3.4 相关知识3.4.1 TTL数字集成电路与CMOS数字集成电路3.4.2 印制电路板的生产工艺3.4.3 印制电路板的质量检验3.5 任务总结3.6 练习与巩固第4章 通孔插装元器件的自动焊接工艺4.1 任务驱动：双声道音响功放电路板的波峰焊接4.1.1 任务描述4.1.2 任务目标4.1.3 任务要求4.2 任务资讯4.2.1 浸焊4.2.2 波峰焊技术4.2.3 波峰焊机4.2.4 波峰焊接缺陷分析4.3 任务实施4.3.1 电路板插装波峰焊接工艺设计4.3.2 通孔插装元器件的检测与准备4.3.3 通孔插装元器件的插装4.3.4 波峰焊接设备的准备4.3.5 波峰焊接的实施4.3.6 装接后的检查测试4.4 相关知识4.4.1 焊接工艺概述4.4.2 新型焊接4.5 任务总结4.6 练习与巩固第5章 表面贴装元器件电子产品的手工装接5.1 任务驱动：贴片调频收音机的手工装接5.1.1 任务描述5.1.2 任务目标5.1.3 任务要求5.2 任务资讯5.2.1 表面贴装技术5.2.2 表面贴装元器件5.2.3 表面贴装工艺的材料5.2.4 表面贴装元器件的手工装接工艺5.3 任务实施5.3.1 装接工艺设计5.3.2 元器件的检测与准备5.3.3 印制电路板的手工装接5.3.4 装接后的检查测试5.4 相关知识5.4.1 SMT元器件的手工拆焊5.4.2 BGA集成电路的修复性植球5.5 任务总结5.6 练习与巩固第6章 表面安装元器件的贴片再流焊工艺6.1 任务驱动：调幅/调频收音机电路板的贴片再流焊接6.1.1 任务描述6.1.2 任务目标6.1.3 任务要求6.2 任务资讯6.2.1 表面安装元器件的贴焊工艺6.2.2 贴片机的结构与工作原理6.2.3 再流焊接机6.3 任务实施6.3.1 电路板贴片再流焊接工艺设计6.3.2 电子元器件检测与准备6.3.3 表面贴装电子元器件的装贴6.3.4 再流焊接设备的特点6.3.5 再流焊接的实施6.3.6 装接后的检查测试6.4 相关知识6.4.1 表面组装涂敷技术6.4.2 再流焊质量缺陷分析6.5 任务总结6.6 练习与巩固第7章 电子产品整机装配工艺7.1 任务驱动：数字万用表整机装配7.1.1 任务描述7.1.2 任务目标7.1.3 任务要求7.2 任务资讯7.2.1 电子产品整机装配基础7.2.2 电路板组装7.2.3 电子产品整机组装7.2.4 电子产品整机质检7.3 任务实施7.3.1 整机装配的工艺设计7.3.2 元器件的检测与准备7.3.3 电路板的装配焊接7.3.4 整机装配7.4 相关知识7.4.1 电子产品专职检验工艺7.4.2 电子产品包装工艺7.5 任务总结7.6 练习与巩固第8章 电子产品的调试工艺8.1 任务驱动：调幅收音机的调试8.1.1 任务描述8.1.2 任务目标8.1.3 任务要求8.2 任务资讯8.2.1 电子产品调试设备与内容8.2.2 电子产品的检测方法8.2.3 电子产品静态调试8.2.4 电子产品动态调试8.3 任务实施8.3.1 整机调试的工艺设计8.3.2 静态调试8.3.3 动态调试8.3.4 统调8.4 相关知识8.5 任务总结8.6 练习与巩固第9章 电子工艺文件的识读与编制9.1 任务驱动：电视机基板工艺文件的识读与编制9.1.1 任务描述9.1.2 任务目标9.1.3 任务要求9.2 任务资讯9.2.1 工艺文件基础9.2.2 工艺文件格式9.2.3 工艺文件内容9.2.4 工艺文件编制9.2.5 常见的工艺文件9.3 任务实施9.3.1 识读电子产品的技术文件9.3.2 编制插件工艺流程和工艺文件9.4 相关知识9.4.1 电子产品的生产组织9.4.2 电子产品的生产质量管理9.5 任务总结9.6 练习与巩固参考文献

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com